【原因・判断ポイント・発生工程】 微細な繊維などがスルーホール内や、銀ペースト内に介在し銀ペーストの充填を阻害して出来たもの(銀スルーホール印刷工程)

【原因、判断要点、发生工序】在通孔内或者银膏内夹杂细微的纤维,妨碍银膏的填充所引起的(银通孔印刷工序)。

#### [Causes/processes involved/keys to judgment]

A fine fiber or the like that is present in the through hole or in silver paste prevents the complete filling of silver paste (Silver paste printing process)



[コメント] 銀ペースト充填不足による表面銅導体との断線 顕微鏡倍率×50

#### 【注释】

银膏填充不足引起的表面铜导线的开路 显微镜倍率 × 50

#### [Coments]

The discontinuity between silver paste through-hole and surface conductor caused by insufficient paste filling. Magnification: ×50

# 5-2-2 銀スル首部ペースト厚過剰/银通孔颈的银膏过剩/IExcessive silver paste thickness at hole neck

**【特徴】**銀ペーストの厚さがスルーホール首部で異常に厚くなっている状態の欠陥

【特征】在银通孔勃颈的银膏非常厚的缺陷。

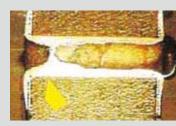
**[Characteristics]** Silver paste is unusually thick at the neck of a through hole.

**【原因・判断ポイント・発生工程】**銀ペースト粘度 異常により出来たもの(銀スルーホール形成工程)

【原因、判断要点、发生工序】银膏的粘度异常所造成的(银通孔形成工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by an abnormally high viscosity of silver paste (Silver through hole formation process)



| 【コメント】 | 顕微鏡倍率× 20

□ [注释]
□ 显微镜倍率 × 20

[Coments] Magnification: ×20



【コメント】 | 顕微鏡倍率× 20

□ [注释]
□ 显微镜倍率 × 20

[Coments]
Magnification: ×20

## 5-2-3 銀スルオーバコートズレ/银通孔的表面涂层的偏移/ Displaced overcoat silver of through hole

【特徴】銀スルーホール用オーバコートがズレて銀ペースト部の一部が露出している状態の欠陥

【特征】银通孔的表面涂层偏移,局部露出银膏的缺陷。

**[Characteristics]** A part of silver pasted area is exposed due to a displaced overcoat.



【コメント】 顕微鏡倍率× 20

□ [注释] □ 显微镜倍率 × 20

[Coments]

Magnification: ×20